

PRESSEKONTAKT

Daniel Klemisch, Product Marketing Specialist

ODU GmbH & Co. KG

Pregelstraße 11 · 84453 Mühldorf a. Inn

Telefon: +49 8631 6156-1695

E-Mail: daniel.klemisch@odu.de

PRESSEINFORMATION

Mühldorf a. Inn, 10.01.2025

EINE NEUE ÄRA FÜR FIBER OPTIC ÜBERTRAGUNG ODU EXPANDED BEAM PERFORMANCE PORTFOLIO MIT LÖSUNGEN NACH VITA- STANDARD

Aktuelle Fiber Optic Verbindungslösungen für Embedded Computing unterliegen Beschränkungen, die für Endanwender im Bereich der Luftfahrt und militärischer Anwendungen ein Problem darstellen. Zu diesen Einschränkungen zählen vor allem eine niedrige Anzahl an Steckzyklen und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung der Interfaces. Die neuen Expanded Beam Performance Produkte schaffen hier Abhilfe und bieten einen echten Mehrwert für System und Anwender. Mit einer hohen Anzahl an Steckzyklen, der hohen Schmutztoleranz und ausgezeichneten Übertragungswerten bieten die Produkte einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Systeme sind sowohl in Singlemode als auch in Multimode Version verfügbar. Aufgrund ihrer geringen Größe kann die Ferrule sowohl in Rundsteckverbinder als auch in Backplane-Steckverbinder integriert werden.

Das Herz des neuen Portfolios bildet ein Kassettensystem, welches die Aneinanderreihung mehrerer Ferrulen auf platzsparende Weise ermöglicht. Mit je 12 angeschlossenen Fasern pro Ferrule können bis zu 96 Glasfasern mit einem Steckverbinder verbunden werden. Die Technologie ist sowohl in klassischen I/O-Rundsteckverbindern, als auch erstmals in Backplane-Verbindungssystemen nach VITA Standard erhältlich. Sie besticht neben hervorragenden Übertragungswerten vor allem mit ihrer extremen Widerstandsfähigkeit. Durch die Streuung des Lichtsignals nach dem Expanded-Beam-Prinzip entfällt der für Physical Contact Lösungstypische hohe Wartungsaufwand.

Expanded Beam Performance

...ist eine fortschrittliche Kontakttechnologie zur Übertragung von Lichtsignalen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Resistenz gegen Verunreinigung, eine hohe Anzahl an Steckzyklen und hervorragende Übertragungseigenschaften aus.

Kontakttechnologie: Expanded Beam **Einfügedämpfung:**

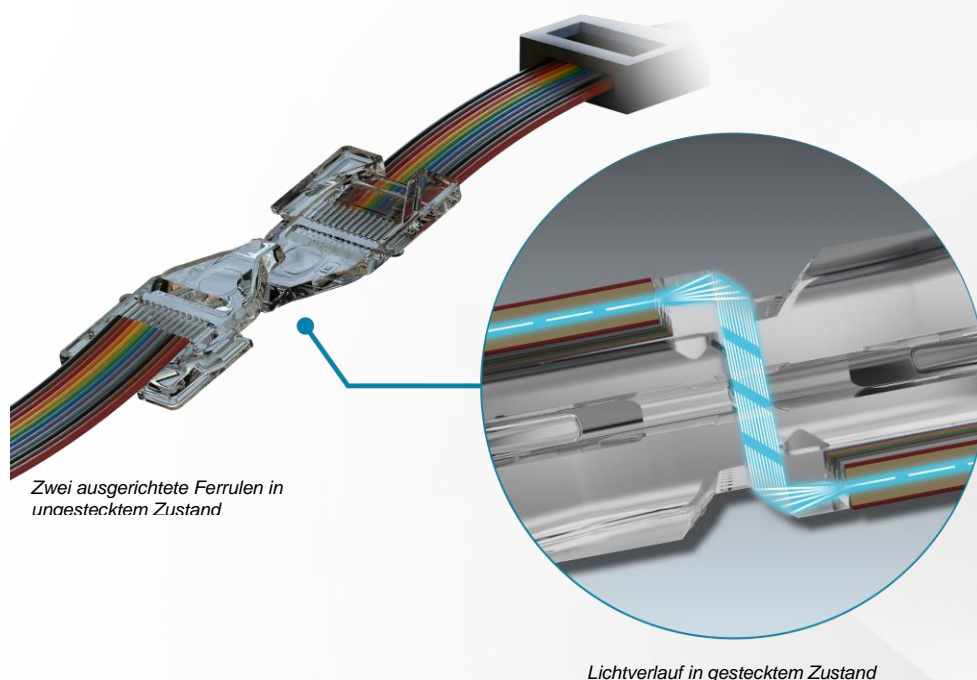
Multimode: < 0,15 dB (typical)
Singlemode: < 0,35 dB (typical)

Rückflusdämpfung:

Multimode: > 45 dB (typical)
Singlemode: > 60 dB (typical)

Steckzyklen: mind. 50.000

Reinigung: keine Reinigung unter normalen Bedingungen



ODU TACTICS // VITA 95

Der Rundsteckverbinder ermöglicht die kompakte Kombination mehrerer Expanded Beam Performance Ferrulen und orientiert sich dabei am anstehenden VITA 95 Standard. ODU TACTICS steht für vier unterschiedliche Größen von Steckverbindern im MIL-DTL-38999, Serie III Gehäuse und ermöglicht je nach Konfiguration die Verbindung von bis zu 96 Glasfasern. Das Design zeichnet sich durch seine Robustheit aus und gilt bereits seit geraumer Zeit als Marktstandard im militärischen Umfeld. Die Verbindungslösung bildet die wartungsarme Alternative zu Produkten nach VITA 87 und VITA 89.

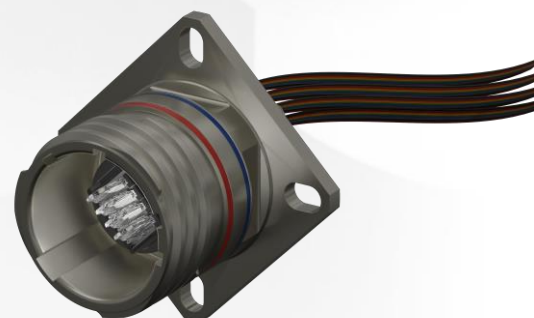


Abbildung 1: ODU TACTICS nach VITA 95

VITA 95			
Shell Size 11	Shell Size 13	Shell Size 15	Shell Size 17
Bis zu 24 Fasern	Bis zu 48 Fasern	Bis zu 72 Fasern	Bis zu 96 Fasern

Tabelle 1: ODU TACTICS Varianten

ODU AMC® Serie T

Die Alternative zum standardisierten MIL-DTL-38999, Serie III Steckverbinder überzeugt durch ein innovatives Verriegelungsprinzip und einen kleineren Außendurchmesser. Qualifiziert auf Basis des 38999 Teststandards, erfüllt die Linie alle Anforderungen zum Einsatz in extremen Umgebungen und punktet dabei mit geringerem Gewicht und kleinerem Formfaktor. Kupplungen sind hier im gewohnten Vierkantflansch-Design, aber auch als Jam-Nut-Variante erhältlich. Die Systeme ermöglichen eine sichere Verbindung über mindestens 5.000 Steckzyklen, ohne dass eine Reinigung erfolgen muss.



Abbildung 2: AMC Serie T Lösungen als State-of-the-Art Verbindung.

AMC Serie T			
Shell Size* 9	Shell Size* 12	Shell Size* 14	Shell Size* 16
Bis zu 24 Fasern	Bis zu 48 Fasern	Bis zu 72 Fasern	Bis zu 96 Fasern

Abbildung 2: AMC Serie T Varianten
*Shell Size gilt für ODU AMC® Serie T

ODU BACKPLANE // VITA 96

Am kommenden VITA 96 Standard orientiert, ermöglicht die BACKPLANE-Linie die direkte Verbindung von Modul und Backplane. Die drei Varianten: VITA 96.1, VITA 96.4 und VITA 96.5 passen auf die Cut-Outs der marktüblichen VITA 66.1, VITA 66.4 und VITA 66.5 Lösungen und ermöglichen so eine einfache Integration der innovativen Technologie. Mit einer Lebensdauer von mindestens 10.000 Steckzyklen eignet sich die Verbindungslösung ideal für Anwendungen, die bei einer langen Nutzdauer regelmäßig mit unterschiedlichen Modulen bestückt werden müssen.

Für detaillierte Informationen rund um das neue Portfolio sowie eine digitale Version besuchen Sie odu-aerospace.com.



Abbildung 3: ODU BACKPLANE nach VITA 96.1 verbindet bis zu 96 Glasfasern.



Die Unternehmensgruppe ODU: mit perfekten Verbindungen weltweit präsent

ODU zählt zu den international führenden Anbietern von Steckverbindingssystemen und beschäftigt weltweit rund 2.700 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Firmengruppe ist Mühldorf a. Inn. Weitere Produktions- und Produktentwicklungsstandorte sind in Sibiu / Rumänien, Shanghai / China, Tijuana / Mexiko und Camarillo / USA. Das Unternehmen vereint unter einem Dach alle relevanten Kompetenzen und Schlüsseltechnologien für Konstruktion und Entwicklung, Werkzeug- und Sondermaschinenbau, Spritzerei, Stanzerei, Dreherei, Oberflächentechnik, Montage sowie Kabelkonfektionierung. Die ODU Gruppe ist mit ihren Produkten global vertreten und verfügt über ein internationales Vertriebsnetzwerk. Dazu gehören eigene Vertriebsgesellschaften in China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Österreich, Schweden, UK und den USA sowie zahlreiche weltweite Vertriebspartner. Steckverbindungen von ODU sorgen in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungsbereichen für eine zuverlässige Übertragung von Leistung, Signalen, Daten und Medien: so in der Medizintechnik, Militär- und Sicherheitstechnik, Automotive ebenso wie in der Industrieelektronik oder Mess- und Prüftechnik.